证券代码:603501 证券简称:韦尔股份 公告编号:2022-083
转债代码:113616 转债简称:韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议于 2022 年 7 月 15 日以现场及通讯方式召开,会议于 2022 年 7 月 10 日以通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》(以下简称"《业务监管规定》")及上海证券交易所《上海证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法》等相关监管规定,公司拟发行全球存托凭证(Global Depository Receipts,以下简称"GDR"),并申请在瑞士证券交易所挂牌上市(以下简称"本次发行上市"或"本次发行"),GDR 以新增发的公司人民币普通股(A 股)(以下简称"A 股股票")作为基础证券。

为完成本次发行上市,公司拟根据相关法律法规的规定转为境外募集股份有限公司,并根据 GDR 招股说明书所载条款及条件,向符合相关条件的投资者发行 GDR。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)逐项审议通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》

1、发行证券的种类和面值

本次发行的证券为全球存托凭证(Global Depository Receipts,GDR),其以新增发的 A 股股票作为基础证券,并在瑞士证券交易所挂牌上市。

每份 GDR 的面值将根据所发行的 GDR 与基础证券 A 股股票转换率确定。每份 GDR 代表按最终确定的转换率计算所得的相应数量的、每股面值人民币 1 元的 A 股股票。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、发行时间

公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市,具体发行时间将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据境内外资本市场情况和境内外监管部门审批进展情况决定。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、发行方式

本次发行方式为国际发行。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、发行规模

公司本次发行 GDR 所代表的新增基础证券 A 股股票(包括因任何超额配股权获行使而发行的证券(如有)),不超过本次发行前公司普通股总股本的 5%。按照截至 2022 年 6 月 30 日公司的总股本测算,不超过 43,851,612 股。若至发行日期间公司股票发生送股、资本公积金转增股本或配股等除权行为,或者因股份回购、实施股权激励计划、可转债转股等导致发行时公司总股本发生变化的,则本次发行 GDR 所代表的新增基础证券 A 股股票的数量将按照相关规定进行相应调整。

最终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5、GDR 在存续期内的规模

公司发行的 GDR 在存续期内的数量上限按照发行前确定的 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率及作为 GDR 基础证券的 A 股股票数量计算确定,前述 A 股股票数量不超过公司本次发行上市完成前普通股总股本的 5%。因公司送股、资本公积金转增股本、配股、股份分拆或者合并导致基础证券 A 股股票数量发生变化或因转换率调整等原因,导致 GDR 增加或者减少的,GDR 在存续期内的数量上限相应调整。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、GDR 与基础证券 A 股股票的转换率

本次发行的 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率将综合考虑境内外监管要求、市场情况等因素确定。

董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

7、定价方式

本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下,根据国际惯例和《业务监管规定》等相关监管要求,综合考虑订单需求和簿记建档结果,根据发行时境内外资本市场情况确定。本次发行价格按照 GDR 与 A 股股票转换率计算后的金额将不低于法律法规要求或有权监管部门同意的价格。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

8、发行对象

本次 GDR 拟在全球范围内进行发售,拟面向合格国际投资者,及其他符合相关规定的投资者发行。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

9、GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期

本次发行的 GDR 以承销团通过簿记建档后国际发售的方式进行承销。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

10、承销方式

本次发行的 GDR 以承销团通过簿记建档后国际发售的方式进行承销。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

11、募集资金及实施主体

本次发行的 GDR 募集资金净额为人民币 2,387,161,000.00 元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字[2021]第 ZA10003 号《验资报告》。

截至 2022 年 3 月 31 日止,本公司募集资金使用情况及结余情况如下:

募集资金账户情况	发行可转换公司债券募集资金额(元)
募集资金总额	2,440,000,000.00
减:发行费用	52,839,000.00
募集资金净额	2,387,161,000.00
加:累计利息收入及手续费支出净额	7,125,259.44
加:其他	1.00
减:置换以自筹资金预先投入募集项目	120,888,627.29
减:募集资金投入募集项目	474,289,742.20
募集资金账户余额	1,799,107,890.95

(二)募集资金在专项账户的存放情况

截至 2022 年 3 月 31 日止,公司公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	开户公司	银行账号	存放金额
招商银行股份有限公司上海张江支行	上海韦尔半导体股份有限公司	121908236710307	815,386.17
平安银行股份有限公司上海分行	上海韦尔半导体股份有限公司	15006188888809	394,246.34
中国民生银行股份有限公司上海分行	上海韦尔半导体股份有限公司	632634897	41,644.74
兴业银行股份有限公司上海嘉定支行	豪威半导体(上海)有限责任公司	216130100100280966	3,818,270.60
兴业银行股份有限公司上海嘉定支行	豪威半导体(上海)有限责任公司	216130100100307182	826,608,384.68
兴业银行股份有限公司上海嘉定支行	豪威半导体(上海)有限责任公司	216130100100307203	139,947,163.39
兴业银行股份有限公司上海嘉定支行	豪威半导体(上海)有限责任公司	216130100100307312	56,397,580.88
平安银行股份有限公司上海分行	豪威科技(上海)有限公司	15119618888860	1.00
平安银行股份有限公司上海分行	OmniVision Technologies, Inc.	FTN15555788816865	771,085,213.15
合计	/	/	1,799,107,890.95

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

1、募集资金投资项目实施主体变更情况

2021 年 1 月 18 日,公司召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》。公司决定将募投项目之一"CMOS 图像传感器研发升级"实施主体由豪威科技(上海)有限公司增加为豪威科技(上海)有限公司和 OmniVision Technologies, Inc.共同实施。上述部分募投项目增加实施主体事项没有改变募集资金的用途和投向,募投项目建设内容不发生变化。平安证券股份有限公司出具了《关于上海韦尔半导体股份有限公司部分募集资金投资项目增加实施主体的核查意见》,对公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体的事项无异议。

2、募集资金投资项目变更情况

2021 年 7 月 13 日,公司召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第三十六次审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》。公司决定减少原募集资金投资项目之一"晶圆测试及晶圆重构生产线项目(二期)"的投资金额,并将调整后募集资金用于新增的"晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目"、"高性能图像传感器芯片测试扩产项目"和"硅基液晶投影显示芯片封测扩产项目"。可转换公司债券募投项目其他内容均保持不变。

本次募集资金变更前后情况如下:

单位:万元

变更前项目名称	变更前计划投入募集资金总额	变更后项目名称	变更后计划投入募集资金总额
晶圆测试及晶圆重构生产线项目(二期)	130,000.00	晶圆测试及晶圆重构生产线项目(二期)	18,441.54
CMOS 图像传感器研发升级	80,000.00	CMOS 图像传感器研发升级	80,000.00
补充流动资金	34,000.00	补充流动资金	34,000.00
		晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目	83,482.95
		高性能图像传感器芯片测试扩展项目	20,899.15
		硅基液晶投影显示芯片封测扩展项目	7,316.53
合计	244,000.00	合计	244,140.18

注:变更后募集资金合计金额与变更前募集资金合计金额差异为募集资金利息收入。

截至 2021 年 6 月 30 日止,"晶圆测试及晶圆重构生产线项目(二期)"已累计使用本次募集资金 14,890.17 万元,募集资金使用率为 11.45%。该项目募集资金专户产生利息收入 140.18 万元,募集资金专户余额为 115,250.00 万元,募集资金投资项目变更后,其中 3,551.37 万元将继续用于晶圆测试及晶圆重构生产线项目(二期)项目投资,111,698.63 万元拟变更用于晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目、高性能图像传感器芯片测试扩产项目和硅基液晶投影显示芯片封测扩产项目。

本次募集资金项目变更有利于公司提高募集资金使用效率,抓住 CMOS 图像传感器行业的发展机遇,提升公司在相关领域的产品研发和生产能力,更好的满足下游多样化的市场需求。上述事项已经公司于 2021 年 8 月 2 日召开的 2021 年第一次临时股东大会及 2021 年第一次债券持有人会议审议通过。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。平安证券股份有限公司出具了《关于上海韦尔半导体股份有限公司可转换公司债券募集资金投资项目变更的核查意见》,对公司本次变更可转换公司债券募投项目事项无异议。

(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2021 年 5 月 17 日,公司召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,置换金额为人民币 120,888,627.29 元。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2021]第 ZA13801 号《关于上海韦尔半导体股份有限公司以可转债募集资金预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》;平安证券股份有限公司出具了《关于上海韦尔半导体股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

截至 2022 年 3 月 31 日止,公司发行可转换公司债券募集资金置换累计金额为 120,888,627.29 元。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 3 月 31 日止,公司使用公开发行可转换公司债券募集资金投资的项目尚未达到预定可使用状态,尚未产生经济效益。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

"补充流动资金"项目募集资金全部用于补充公司流动资金,不适用单独核算实现效益情况。

四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2022 年 7 月 16 日

本议案需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

同意公司根据本次 GDR 发行上市后适用的《公司章程(草案)》,相应修订《上海韦尔半导体股份有限公司董事会议事规则》(以下简称"《董事会议事规则》"),形成《上海韦尔半导体股份有限公司董事会议事规则(草案)》(以下简称"《董事会议事规则(草案)》")。

该修订后的《董事会议事规则(草案)》经股东大会批准后,自 GDR 成功发行上市之日起生效。在此之前,现行《董事会议事规则》将继续适用。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于制定<上海韦尔半导体股份有限公司境外发行证券及上市相关的保密和档案管理制度>的议案》

鉴于公司拟发行 GDR 并申请在瑞士证券交易所挂牌上市,同意公司根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《关于加强在境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律、法规、规范性文件的规定以及相关监管要求拟定的《上海韦尔半导体股份有限公司境外发行证券及上市相关的保密和档案管理制度》(以下简称"《保密和档案管理制度》")。

《保密和档案管理制度》经董事会审议通过后即生效。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十四)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,同意提请于 2022 年 8 月 2 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会,审议本次董事会审议通过需要提交股东大会审议的相关议案。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-085)。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2022 年 7 月 16 日

证券代码:603501 证券简称:韦尔股份 公告编号:2022-086
转债代码:113616 转债简称:韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司 实施 2021 年度权益分派时"韦尔转债"停止转股的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 2021 年度权益分派公告前一交易日(2022 年 7 月 21 日)至权益分派股权登记日期间,"韦尔转债"将停止转股。

一、权益分派方案的基本情况

2022 年 6 月 27 日,上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称"公司")召开 2021 年年度股东大会审议通过了《2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,确定公司以本次利润分配方案实施前的公司总股本为基数,每 10 股派发现金红利 5.20 元(含税),预计分配现金红利总额为 455,376,768.60 元(含税),占公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 10.17%,并同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3.5 股,不送红股,预计共计转增 306,503,595 股。如在实施权益分派前,公司总股本发生变动的,公司将维持每股分配和转增比例不变,相应调整分配和转增总额。

本次权益分派方案实施后,公司将根据《上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规定,对"韦尔转债"当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排

(一)公司将于 2022 年 7 月 22 日在指定信息披露媒体上发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

(二)自 2022 年 7 月 21 日至权益分派股权登记日期间,"韦尔转债"将停止转股,股权登记日后的第一个交易日起"韦尔转债"恢复转股,欲享受权益分派的可转债持有人可在 2022 年 7 月 20 日(含 2022 年 7 月 20 日)之前进行转股。

三、其他

联系人:公司证券投资部

咨询电话:021-50805043

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2022 年 7 月 16 日

证券代码:603501 证券简称:韦尔股份 公告编号:2022-083
转债代码:113616 转债简称:韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定,上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称"公司")将截至 2022 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 13 日签发的证监许可[2020]3024 号文《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》,公司获准向社会公开发行 244,000 万元可转换公司债券,期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 2,440,000,000.00 元,扣除承销及保荐费用、律师费用、审计验资费用、资信评级费及信息披露费用等其他发行费用合计人民币 52,839,000.00 元(含税),实际募集资金净额为人民币 2,387,161,000.00 元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字[2021]第 ZA10003 号《验资报告》。

截至 2022 年 3 月 31 日止,本公司募集资金使用情况及结余情况如下:

募集资金账户情况	发行可转换公司债券募集资金额(元)
募集资金总额	2,440,000,000.00
减:发行费用	52,839,000.00
募集资金净额	2,387,161,000.00
加:累计利息收入及手续费支出净额	7,125,259.44
加:其他	1.00
减:置换以自筹资金预先投入募集项目	120,888,627.29
减:募集资金投入募集项目	474,289,742.20
募集资金账户余额	1,799,107,890.95

(二)募集资金在专项账户的存放情况

截至 2022 年 3 月 31 日止,公司公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	开户公司	银行账号	存放金额
招商银行股份有限公司上海张江支行	上海韦尔半导体股份有限公司	121908236710307	815,386.17
平安银行股份有限公司上海分行	上海韦尔半导体股份有限公司	15006188888809	394,246.34
中国民生银行股份有限公司上海分行	上海韦尔半导体股份有限公司	632634897	41,644.74
兴业银行股份有限公司上海嘉定支行	豪威半导体(上海)有限责任公司	216130100100280966	3,818,270.60
兴业银行股份有限公司上海嘉定支行	豪威半导体(上海)有限责任公司	216130100100307182	826,608,384.68
兴业银行股份有限公司上海嘉定支行	豪威半导体(上海)有限责任公司	216130100100307203	139,947,163.39
兴业银行股份有限公司上海嘉定支行	豪威半导体(上海)有限责任公司	216130100100307312	56,397,580.88
平安银行股份有限公司上海分行	豪威科技(上海)有限公司	15119618888860	1.00
平安银行股份有限公司上海分行	OmniVision Technologies, Inc.	FTN15555788816865	771,085,213.15
合计	/	/	1,799,107,890.95

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

1、募集资金投资项目实施主体变更情况

2021 年 1 月 18 日,公司召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》。公司决定将募投项目之一"CMOS 图像传感器研发升级"实施主体由豪威科技(上海)有限公司增加为豪威科技(上海)有限公司和 OmniVision Technologies, Inc.共同实施。上述部分募投项目增加实施主体事项没有改变募集资金的用途和投向,募投项目建设内容不发生变化。平安证券股份有限公司出具了《关于上海韦尔半导体股份有限公司部分募集资金投资项目增加实施主体的核查意见》,对公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体的事项无异议。

2、募集资金投资项目变更情况

2021 年 7 月 13 日,公司召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第三十六次审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》。公司决定减少原募集资金投资项目之一"晶圆测试及晶圆重构生产线项目(二期)"的投资金额,并将调整后募集资金用于新增的"晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目"、"高性能图像传感器芯片测试扩产项目"和"硅基液晶投影显示芯片封测扩产项目"。可转换公司债券募投项目其他内容均保持不变。

本次募集资金变更前后情况如下:

单位:万元

变更前项目名称	变更前计划投入募集资金总额	变更后项目名称	变更后计划投入募集资金总额
晶圆测试及晶圆重构生产线项目(二期)	130,000.00	晶圆测试及晶圆重构生产线项目(二期)	18,441.54
CMOS 图像传感器研发升级	80,000.00	CMOS 图像传感器研发升级	80,000.00
补充流动资金	34,000.00	补充流动资金	34,000.00
		晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目	83,482.95
		高性能图像传感器芯片测试扩展项目	20,899.15
		硅基液晶投影显示芯片封测扩展项目	7,316.53
合计	244,000.00	合计	244,140.18

注:变更后募集资金合计金额与变更前募集资金合计金额差异为募集资金利息收入。

截至 2021 年 6 月 30 日止,"晶圆测试及晶圆重构生产线项目(二期)"已累计使用本次募集资金 14,890.17 万元,募集资金使用率为 11.45%。该项目募集资金专户产生利息收入 140.18 万元,募集资金专户余额为 115,250.00 万元,募集资金投资项目变更后,其中 3,551.37 万元将继续用于晶圆测试及晶圆重构生产线项目(二期)项目投资,111,698.63 万元拟变更用于晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目、高性能图像传感器芯片测试扩产项目和硅基液晶投影显示芯片封测扩产项目。

本次募集资金项目变更有利于公司提高募集资金使用效率,抓住 CMOS 图像传感器行业的发展机遇,提升公司在相关领域的产品研发和生产能力,更好的满足下游多样化的市场需求。上述事项已经公司于 2021 年 8 月 2 日召开的 2021 年第一次临时股东大会及 2021 年第一次债券持有人会议审议通过。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。平安证券股份有限公司出具了《关于上海韦尔半导体股份有限公司可转换公司债券募集资金投资项目变更的核查意见》,对公司本次变更可转换公司债券募投项目事项无异议。

(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2021 年 5 月 17 日,公司召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,置换金额为人民币 120,888,627.29 元。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2021]第 ZA13801 号《关于上海韦尔半导体股份有限公司以可转债募集资金预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》;平安证券股份有限公司出具了《关于上海韦尔半导体股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

截至 2022 年 3 月 31 日止,公司发行可转换公司债券募集资金置换累计金额为 120,888,627.29 元。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 3 月 31 日止,公司使用公开发行可转换公司债券募集资金投资的项目尚未达到预定可使用状态,尚未产生经济效益。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

"补充流动资金"项目募集资金全部用于补充公司流动资金,不适用单独核算实现效益情况。

四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2022 年 7 月 16 日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额:	244,000.00	已累计使用募集资金总额:	59,517.83
募集资金净额:	238,716.10	各年度使用募集资金总额:	
变更用途的募集资金总额:	111,558.46	2021 年:	53,253.22
变更用途的募集资金总额比例:	46.73%	2022 年 1-3 月:	6,264.61

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资与募集后承诺投资金额的差额(注)	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
1	晶圆测试及晶圆重构生产线项目(二期)	晶圆测试及晶圆重构生产线项目(二期)	130,000.00	18,441.54	18,125.68	130,000.00	18,441.54	18,125.68	-315.86	2022 年 5 月
2	CMOS 图像传感器研发升级	CMOS 图像传感器研发升级	80,000.00	80,000.00	3,086.76	80,000.00	80,000.00	3,086.76	-76,913.24	2024 年 3 月
3	补充流动资金	补充流动资金	28,716.10	28,716.10	28,716.10	28,716.10	28,716.10	28,716.10	0	不适用
4		晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目	0	83,482.95	965.83	0	83,482.95	965.83	-82,517.12	2023 年 7 月
5		高性能图像传感器芯片测试扩展项目	0	20,899.15	6,936.02	0	20,899.15	6,936.02	-13,963.13	2023 年 1 月
6		硅基液晶投影显示芯片封测扩展项目	0	7,316.53	1,687.44	0	7,316.53	1,687.44	-5,629.09	2023 年 8 月
	合计		238,716.10	238,857.27	59,517.83	238,716.10	238,856.27	59,517.83	-179,338.44	/

注:由于公司募投项目尚在建设期,故实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差额。

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019 年度	2020 年度	2021 年度		
1	晶圆测试及晶圆重构生产线项目(二期)	不适用	达产后年均净利润 12,425.22 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	CMOS 图像传感器研发升级	不适用	达产后年均净利润 26,625.25 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目	不适用	达产后年均净利润 10,354.88 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	高性能图像传感器芯片测试扩展项目	不适用	达产后年均净利润 2,787.64 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	硅基液晶投影显示芯片封测扩展项目	不适用	达产后年均净利润 2,695.71 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

证券代码:603501 证券简称:韦尔股份 公告编号:2022-084
转债代码:113616 转债简称:韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三次会议于 2022 年 7 月 15 日以现场及通讯方式召开,会议通知已于 2022 年 7 月 10 日通过通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席韩杰先生主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》(以下简称"《业务监管规定》")及上海证券交易所《上海证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法》等相关监管规定,公司拟发行全球存托凭证(Global Depository Receipts,以下简称"GDR"),并申请在瑞士证券交易所挂牌上市(以下简称"本次发行上市"或"本次发行"),GDR 以新增发的公司人民币普通股(A 股)(以下简称"A 股股票")作为基础证券。

为完成本次发行上市,公司拟根据相关法律法规的规定转为境外募集股份有限公司,并根据 GDR 招股说明书所载条款及条件,向符合相关条件的投资者发行 GDR。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)逐项审议通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》

1、发行证券的种类和面值

本次发行的证券为全球存托凭证(Global Depository Receipts,GDR),其以新增发的 A 股股票作为基础证券,并在瑞士证券交易所挂牌上市。

每份 GDR 的面值将根据所发行的 GDR 与基础证券 A 股股票转换率确定。每份 GDR 代表按最终确定的转换率计算所得的相应数量的、每股面值人民币 1 元的 A 股股票。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、发行时间

公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市,具体发行时间将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据境内外资本市场情况和境内外监管部门审批进展情况决定。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、发行方式

本次发行方式为国际发行。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、发行规模

公司本次发行 GDR 所代表的新增基础证券 A 股股票(包括因任何超额配股权获行使而发行的证券(如有)),不超过本次发行前公司普通股总股本的 5%。按照截至 2022 年 6 月 30 日公司的总股本测算,不超过 43,851,612 股。若至发行日期间公司股票发生送股、资本公积金转增股本或配股等除权行为,或者因股份回购、实施股权激励计划、可转债转股等导致发行时公司总股本发生变化的,则本次发行 GDR 所代表的新增基础证券 A 股股票的数量将按照相关规定进行相应调整。

最终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5、GDR 在存续期内的规模

公司发行的 GDR 在存续期内的数量上限按照发行前确定的 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率及作为 GDR 基础证券的 A 股股票数量计算确定,前述 A 股股票数量不超过公司本次发行上市完成前普通股总股本的 5%。因公司送股、资本公积金转增股本、配股、股份分拆或者合并导致基础证券 A 股股票数量发生变化或因转换率调整等原因,导致 GDR 增加或者减少的,GDR 在存续期内的数量上限相应调整。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、GDR 与基础证券 A 股股票的转换率

本次发行的 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率将综合考虑境内外监管要求、市场情况等因素确定。

董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

7、定价方式

本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下,根据国际惯例和《业务监管规定》等相关监管要求,综合考虑订单需求和簿记建档结果,根据发行时境内外资本市场情况确定。本次发行价格按照 GDR 与 A 股股票转换率计算后的金额将不低于法律法规要求或有权监管部门同意的价格。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

8、发行对象

本次 GDR 拟在全球范围内进行发售,拟面向合格国际投资者,及其他符合相关规定的投资者发行。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

9、GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期

本次发行的 GDR 可以在符合境内外监管要求的情况下,与基础证券 A 股股票进行转换。根据《业务监管规定》的要求,本次发行的 GDR 自上市之日 120 日内不得转换为境内 A 股股票;公司控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的 GDR 自上市之日起 36 个月内不得转让。为保持 GDR 流动性及两地市场价格稳定,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据届时境内外市场情况及公司实际情况,确定设置转换限制期相关事宜。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

10、承销方式

本次发行的 GDR 以承销团通过簿记建档后国际发售的方式进行承销。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

11、募集资金及实施主体

本次发行的 GDR 募集资金净额为人民币 2,387,161,000.00 元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字[2021]第 ZA10003 号《验资报告》。

截至 2022 年 3 月 31 日止,本公司募集资金使用情况及结余情况如下:

募集资金账户情况	发行可转换公司债券募集资金额(元)
募集资金总额	2,440,000,000.00
减:发行费用	52,839,000.00
募集资金净额	2,387,161,000.00
加:累计利息收入及手续费支出净额	7,125,259.44
加:其他	1.00
减:置换以自筹资金预先投入募集项目	120,888,627.29
减:募集资金投入募集项目	474,289,742.20
募集资金账户余额	1,799,107,890.95

(二)募集资金在专项账户的存放情况

截至 2022 年 3 月 31 日止,公司公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	开户公司	银行账号	存放金额
招商银行股份有限公司上海张江支行	上海韦尔半导体股份有限公司	121908236710307	815,386.17
平安银行股份有限公司上海分行	上海韦尔半导体股份有限公司	15006188888809	394,246.34
中国民生银行股份有限公司上海分行	上海韦尔半导体股份有限公司	632634897	41,644.74
兴业银行股份有限公司上海嘉定支行	豪威半导体(上海)有限责任公司	216130100100280966	3,818,270.60
兴业银行股份有限公司上海嘉定支行	豪